國立中山大學半導體及重點科技研究學院
電子材料與機電整合研究所
學生參與實習保密切結書

本人＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿報考國立中山大學半導體及重點科技研究學院電子材料與機電整合研究所，同意於錄取入學後安排至合作企業實習期間所知悉取得或持有之任何資訊與個人資料，無論於實習期間或實習終了後，皆應保密，不得洩漏或交付予任何第三人；除經實習企業許可外，本人同意不得任意蒐集、處理、利用實習企業之任何資訊與個人資料，或利用實習企業之任何資訊與個人資料造成其他可能侵害實習企業之行為。倘若因此致實習企業受有任何損害，本人將負一切責任，概與國立中山大學半導體及重點科技研究學院無涉。

此致

國立中山大學半導體及重點科技研究學院

立切結書人：

姓　　名：　　（簽章）

身分證號碼：

戶籍地址：

聯絡電話：

中　　華　　民　　國　　年　　月　　日

國立中山大學半導體及重點科技研究學院
電子材料與機電整合研究所
學生獎助金核發與返還同意書

本人＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿報考國立中山大學半導體及重點科技研究學院電子材料與機電整合研究所，已詳閱並同意國立中山大學半導體及重點科技研究學院「學生參與實習保密及獎助金核發機制」相關規定，並保證未受領其他有約定就業/實習等附帶服務義務之獎助學金，倘若因此致國立中山大學半導體及重點科技研究學院受有任何損害，本人將負一切責任。

此致

國立中山大學半導體及重點科技研究學院

立同意書人：

姓　　名：　　（簽章）

身分證號碼：

住　　址：

聯絡電話：

中　　華　　民　　國　　年　　月　　日